



VIA collabora con Lucid per sviluppare il VIA Edge AI 3D Developer Kit con processore Qualcomm APQ8096SG Embedded

La soluzione software e hardware di AI integrata migliorerà le capacità di rilevamento in un'ampia gamma di dispositivi e sarà applicabile in ambito security, in robotica e nelle soluzioni di guida autonoma

Milano, 13 novembre 2018 – VIA Technologies, Inc. annuncia oggi la sua collaborazione con la startup Lucid per fornire capacità di rilevamento basate sull'AI a dispositivi a doppia e multipla telecamera nei settori della sicurezza, in ambito retail, nella robotica e per lo sviluppo di applicazioni automotive.

Grazie all'integrazione di 3D Fusion Technology di Lucid e di VIA Edge AI 3D Developer Kit, le telecamere di sicurezza in ambito retail, i robot, i droni e i veicoli autonomi saranno ora in grado di acquisire facilmente profondità di campo accurate e immagini in 3D grazie alle loro configurazioni a doppia o multi-camera, riducendo al contempo i costi ed il consumo energetico e di spazio delle precedenti soluzioni hardware. Mentre VIA costruisce il suo piano d'azione a lungo termine per le soluzioni Edge AI, Lucid sta implementando su ogni piattaforma funzionalità di machine learning.

La soluzione AI 3D di Lucid potenziata grazie all'intelligenza artificiale, nota come 3D Fusion Technology, è attualmente utilizzata in molti dispositivi come telecamere 3D, telecamere di sicurezza, robot e telefoni cellulari, tra cui il RED Hydrogen One, che verrà lanciato a novembre e che sarà privo di componenti hardware basati su emissioni laser. Il VIA Edge 3D Developer Kit include il processore Qualcomm® APQ8096SG embedded con Qualcomm® AI Engine oltre al supporto per più telecamere per aiutare Lucid a fornire prestazioni superiori rispetto alle più comuni soluzioni hardware, includendo le funzionalità di machine learning.

"Grazie a questa entusiasmante collaborazione, VIA e Lucid sono in grado di rispondere alle nuove esigenze che il mercato richiede. Nuove applicazioni non solo in ambito security, ma anche in ambito retail, oltre che nel settore della robotica, sui droni e sui veicoli a guida autonoma", ha dichiarato **Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc.** "Questa collaborazione darà luogo a una combinazione hardware/software in cui VIA fornirà l'Edge AI Developer Kit, personalizzabile e incorporabile, così come sistemi e telecamere, mentre Lucid la sua soluzione AI, che sarà adattata come modulo software. Ciò renderà possibile a tutte le aziende di poter usufruire di una soluzione strettamente integrata".

Nel mercato odierno, le telecamere intelligenti con capacità di rilevamento della profondità di campo sono diventate essenziali nei settori della sicurezza, del retail, della robotica e dell'IoT. Grazie ad applicazioni maggiormente precise, come l'identificazione facciale e il monitoraggio ambientale, è possibile determinare le distanze tra le persone e riconoscere in modo preciso gli oggetti. Per robot, droni e veicoli autonomi, il rilevamento della profondità di campo ha migliorato notevolmente la guida delle automobili, il salvataggio e la ricostruzione degli spazi in 3D, fornendo in questo modo una maggiore autonomia alle macchine stesse. Le attuali soluzioni hardware, basate

su emissioni e laser, hanno una significativa incidenza sul costo totale, così come sulle dimensioni e il consumo energetico dei dispositivi. La soluzione di VIA e Lucid non solo elimina queste problematiche, ma velocizza anche il ridimensionamento e l'implementazione del sistema, consentendo l'integrazione delle capacità di rilevamento della profondità ad un costo, fattore di forma e budget energetico molto più bassi.

*"Questa partnership fornirà una soluzione migliore sia in termini di costi che di prestazioni, dando risposta ai punti più critici per i produttori di dispositivi sul mercato", ha dichiarato **Han Jin, CEO e co-fondatore, Lucid**. "Inoltre, semplifica notevolmente lo sviluppo di un'ampia gamma di dispositivi IoT e a doppia telecamera, rispetto a soluzioni basate su hardware che risultano essere più costose e difficili da gestire".*

Per lanciare questa collaborazione, Lucid e VIA mostreranno un prototipo del VIA Edge AI 3D Developer Kit durante ISC East che si svolgerà a New York dal 14 al 15 novembre. Lo stand VIA è il numero 659.

Il VIA Edge AI 3D Developer Kit sarà distribuito ai clienti per ottenere una prima valutazione; sarà disponibile nei prossimi mesi in quantità limitata, mentre in volumi maggiori a partire da gennaio 2019.

Per ulteriori informazioni: <https://lucidinside.com/> o <https://www.viatech.com/>

Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.viagallery.com/via-lucid-edge-ai-3d-developer-kit/>

A proposito di VIA Technologies, Inc.

VIA Technologies, Inc. è leader globale nello sviluppo di piattaforme embedded e soluzioni di sistema altamente integrate per applicazioni AI, IoT, visione artificiale, veicoli autonomi, sanità e smart city. Con sede centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La sua base di clienti include molti marchi leader mondiali nel settore dell'alta tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'elettronica di consumo.

www.viatech.com

A proposito di Lucid

Lucid è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni software per l'acquisizione 3D e il rilevamento di profondità basato sul machine learning. Sfruttando solo configurazioni a doppia o multicamera, la 3D Fusion Technology è stata implementata in milioni di dispositivi di produzione di massa, dai telefoni cellulari alle telecamere 3D, ai robot e droni, ai sistemi di sicurezza e alle telecamere intelligenti. L'SDK di Lucid consente alle telecamere standard di superare le prestazioni derivanti dall'utilizzo di sistemi di profondità hardware basati sulle emissioni, ciò in termini di costi, spazio e sviluppo, attraverso la formazione nel cloud e la deduzione della profondità.

Per ulteriori informazioni www.lucidinside.com.

Alimentato dalla piattaforma embedded Qualcomm® Snapdragon™ 820, un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc., sussidiaria di Qualcomm Incorporated.

Qualcomm, Snapdragon, Kryo, Adreno e Hexagon sono marchi registrati di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Qualcomm Spectra è un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Kryo, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon e Qualcomm Spectra sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc.

I nomi delle società e dei prodotti citati nel presente documento potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.